

# 臻鼎科技控股 (4958 TT)

## 投資人簡報

2025年08月



# 免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

# 一分鐘認識臻鼎



## 全球第1大

### 印刷電路板製造公司

**2006年** 成立  
(前身華虹電子 1978)

**48,141**  
2024年底員工數



**台灣桃園** 總部



**29** 座工廠

位於大陸、台灣、泰國、  
印度

**NT\$1,716.6億**

2024年營收(13.4% YoY)

**NT\$1,478億**

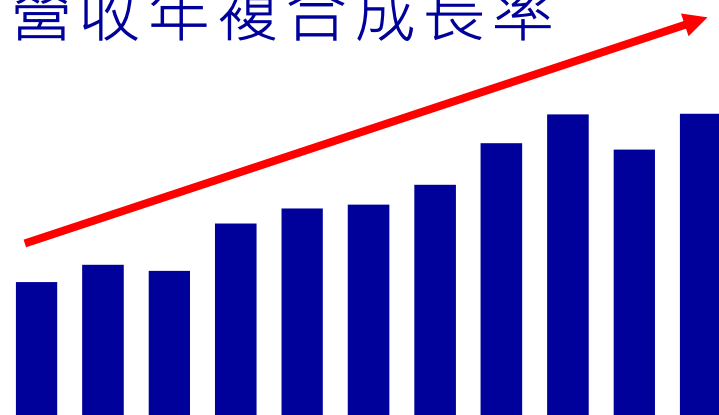
2025年8月14日市值

**13.3%**

10年平均股東權益報酬率  
(2015-2024)

**+9%**

2014-2024年  
營收年複合成長率



**1,868**

累計有效獲證專利件數

**3,866**

累計專利申請

(截至2024年12月底)

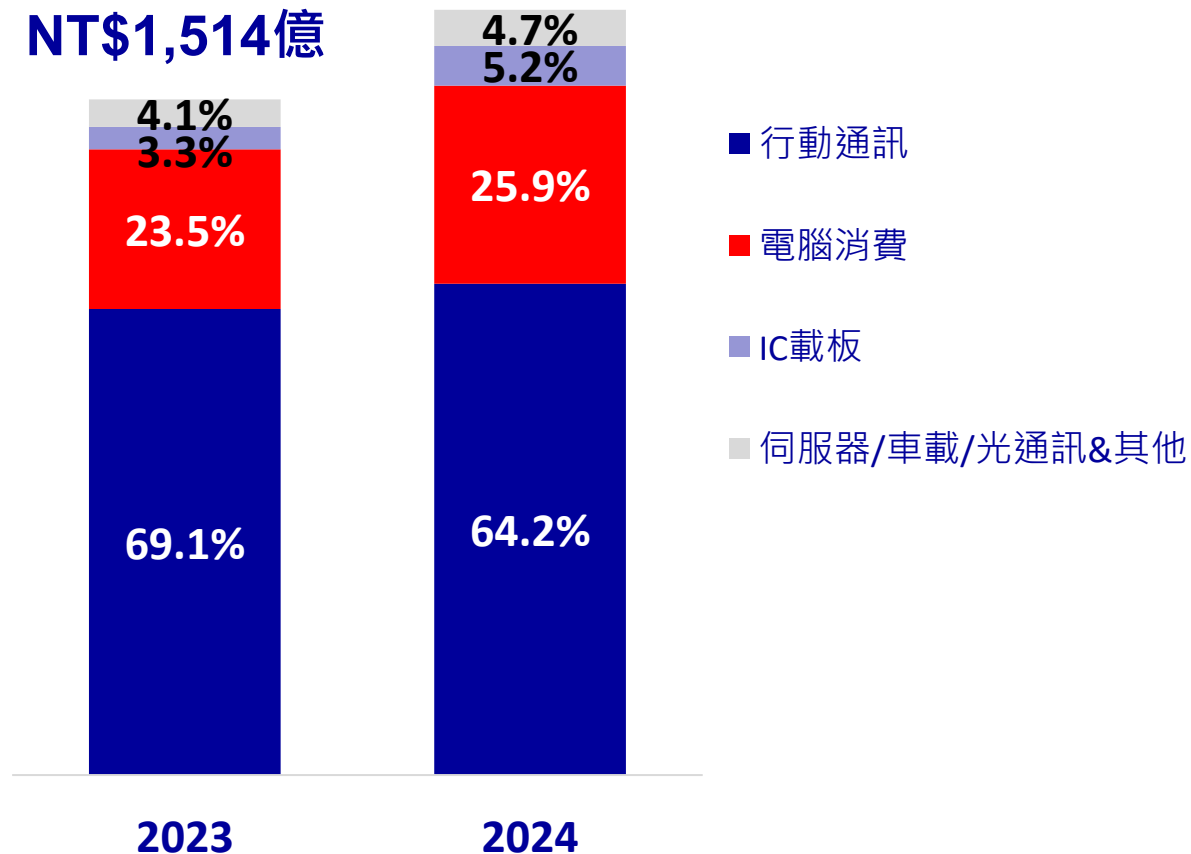


## 銷售分析 – 產品應用別

**+13.4% YoY**

NT\$1,514億

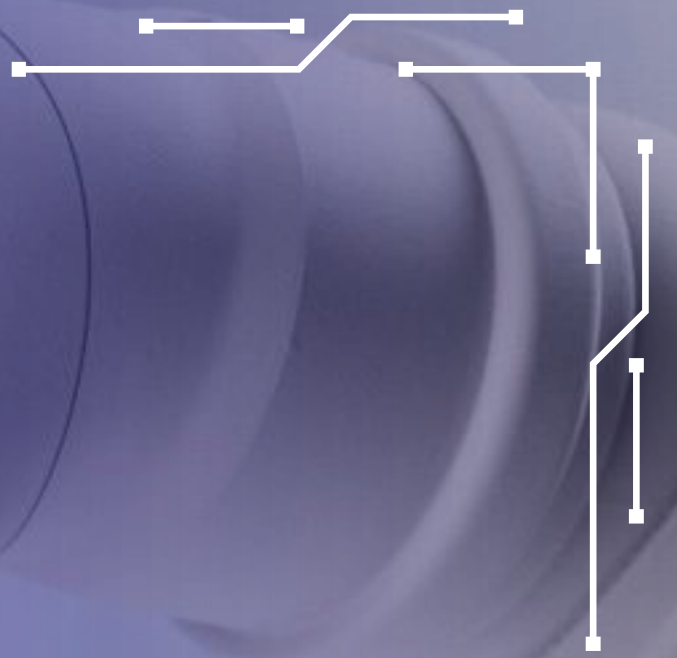
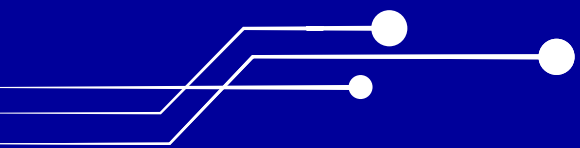
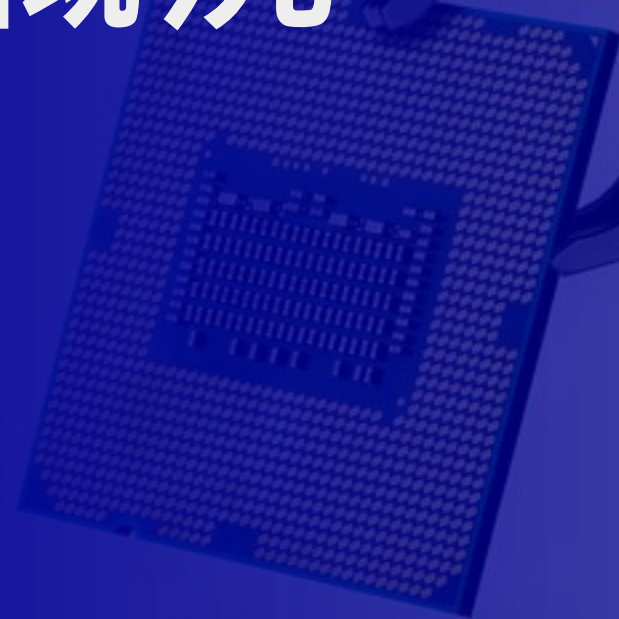
NT\$1,717億





臻鼎科技控股  
Zhen Ding Tech. Holding

# 近期營運概況



# 營運成果回顧暨未來展望

## 1 1H25營收年增20.6%，刷新歷年同期新高紀錄，毛利率與營業利益率皆顯著回升

今年上半年，臻鼎月營收連續六個月創下歷年同期新高。1H25在行動通訊、電腦消費、伺服器/車載/光通訊以及IC載板等四大應用領域皆締造年增表現，其中以IC載板年增幅度最高，符合公司先前預期。

在產能利用率提升與營運費用控制得宜下，雖上半年折舊及攤銷年增新台幣6.78億，上半年毛利率仍較去年同期提高1.7個百分點至16.5%，營業利益率較去年同期回升4.3個百分點至4.4%，營運效率持續優化。業外部分，今年上半年匯兌損失為新台幣6.39億，相較去年上半年匯兌利益11.95億，兩者相差18.34億，縱然有匯兌因素干擾，臻鼎稅後淨利仍達到新台幣24.13億元，年增14.7%，經營成果保持穩健。

## 2 2025年美元營收增速保持優於產業平均水準，2026年四大應用預期全面加速成長

下半年客戶新品備貨節奏正常，下半年營運表現將優於上半年。若以美元計價，2025年全年營收增速保持優於產業平均水準。

展望2026年，臻鼎在AI手機、折疊機與AI眼鏡將有明顯成長機會，加上高階AI伺服器取得重要客戶訂單、IC載板需求升溫，預期四大應用營收將全面加速成長。

# 營運成果回顧暨未來展望 (續)

## 3 One ZDT布局發酵，憑藉高階HDI與HLC技術，未來AI伺服器營收佔比將逐步提升

因應高階AI伺服器技術快速演進，臻鼎是少數能夠提供客戶OAM/UBB技術整合方案的廠商。公司在MSAP、HDI及HLC等領域擁有成熟技術與量產實績，並可配合客戶前瞻設計需求，結合高階載板技術及對半導體產業趨勢的了解，與客戶共同開發未來世代高階產品。

臻鼎過去幾年在AI伺服器累積的技術實力以及對於關鍵製程的掌握已受到重要客戶認可，未來AI伺服器營收佔比將逐步提升。

## 4 因應客戶高階AI產品需求，提高資本支出以掌握未來成長契機

根據客戶對高階AI產品的未來訂單需求，臻鼎規劃提高今、明兩年的資本支出金額至新台幣300億以上，其中近50%資本支出將用於擴大高階HDI和HLC產能，以掌握相關產品成長契機。

以全球產能布局而言，今年大陸廠區將擴建AI產品用高階HDI、HLC產能，以及去瓶頸高階軟板產能。泰國一廠自5/8試產以來，已有伺服器及光通訊領域重要客戶通過認證，預期4Q25將進入小量產；泰國二廠亦積極建設中。另外高雄AI園區之高階ABF載板與HLC+HDI產能陸續裝機，將於年底進入試產。

# 邊緣AI相關應用之營運概況



AI手機/折疊機



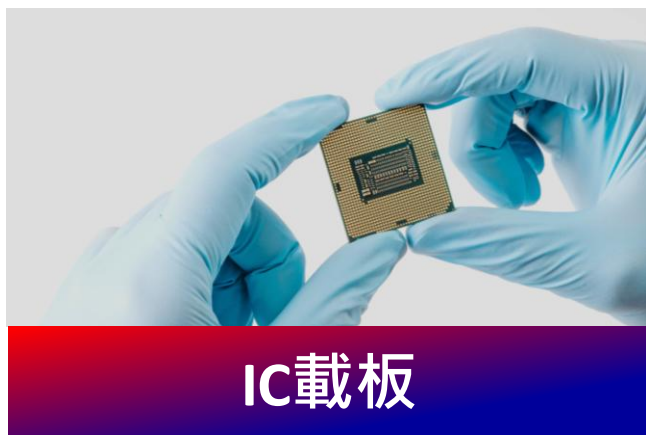
智慧眼鏡/VR/AR



人形機器人

## 明年AI手機、折疊機與AI眼鏡將有更顯著的貢獻，同時積極布局人形機器人商機

- AI趨勢推動客戶產品持續創新與升級，對PCB製程技術的要求亦大幅提升。臻鼎在邊緣AI相關產品具備領先業界的技術，預期明年AI手機、折疊機與AI眼鏡將帶來更顯著的成長貢獻。
- 人形機器人對PCB的技術要求高，主要用於主控系統、感測器模組、電源管理、關節驅動等核心功能。目前臻鼎與多家大陸及國際客戶均已建立合作關係，持續進行產品開發與打樣，以高精度、高密度佈線產品滿足客戶高階PCB需求。



## 高階應用需求提升，營收增速持續優於產業平均

IC載板上半年營收年增34.7%，增速優於產業平均成長。產業供需結構逐步改善，全年預期IC載板仍將是臻鼎四大產品應用中成長最快的業務部門。

ABF載板方面，來自AI資料中心應用的客戶打樣需求明顯增加。臻鼎已具備高階應用所需的技術能力(尺寸超過120mm、層數達26至28層)，可滿足客戶對先進ABF載板的要求。

BT載板方面，邊緣AI的產品升級帶動高階BT載板需求提升，目前產能利用率達90%，營收穩健成長。




## 泰國新廠通過客戶認證後，明年逐步貢獻

高階伺服器、光通訊訂單逐步增加，泰國一廠已通過數家客戶認證，預計4Q25進入小量產，明年可滿足客戶相關產品需求。

AI伺服器方面同步布局GPU與ASIC平台，策略聚焦Advanced HDI與HLC產品，新客戶與新訂單貢獻會在明年開始放大。

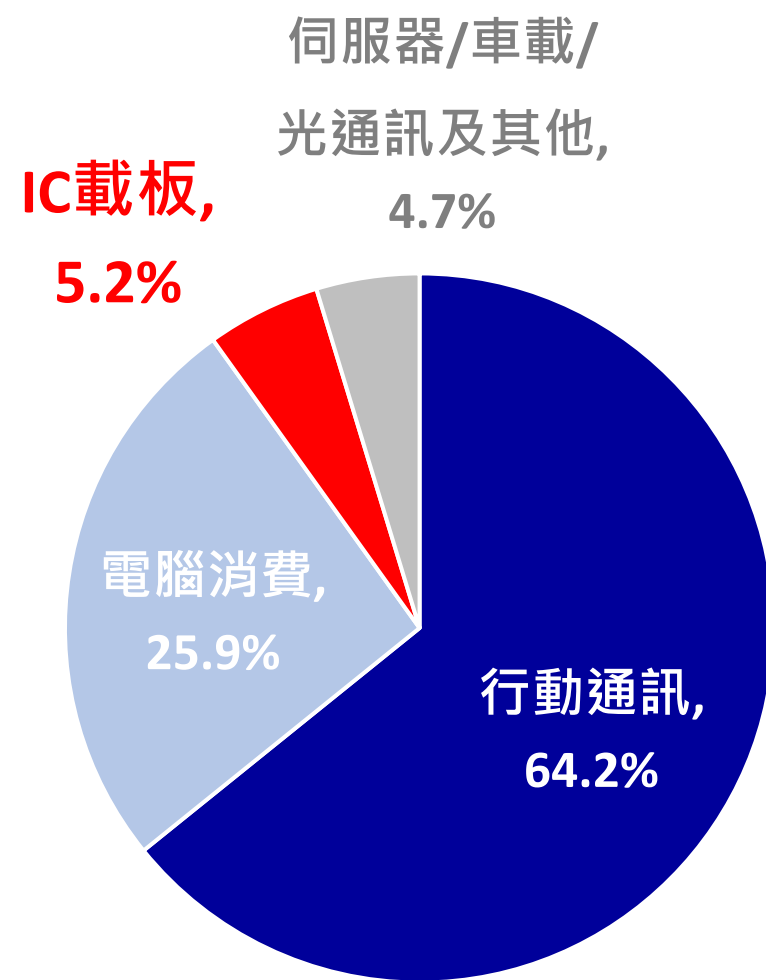
光通訊方面，隨著800G/1.6T光通訊產品的導入量產，明年營收有望倍增。



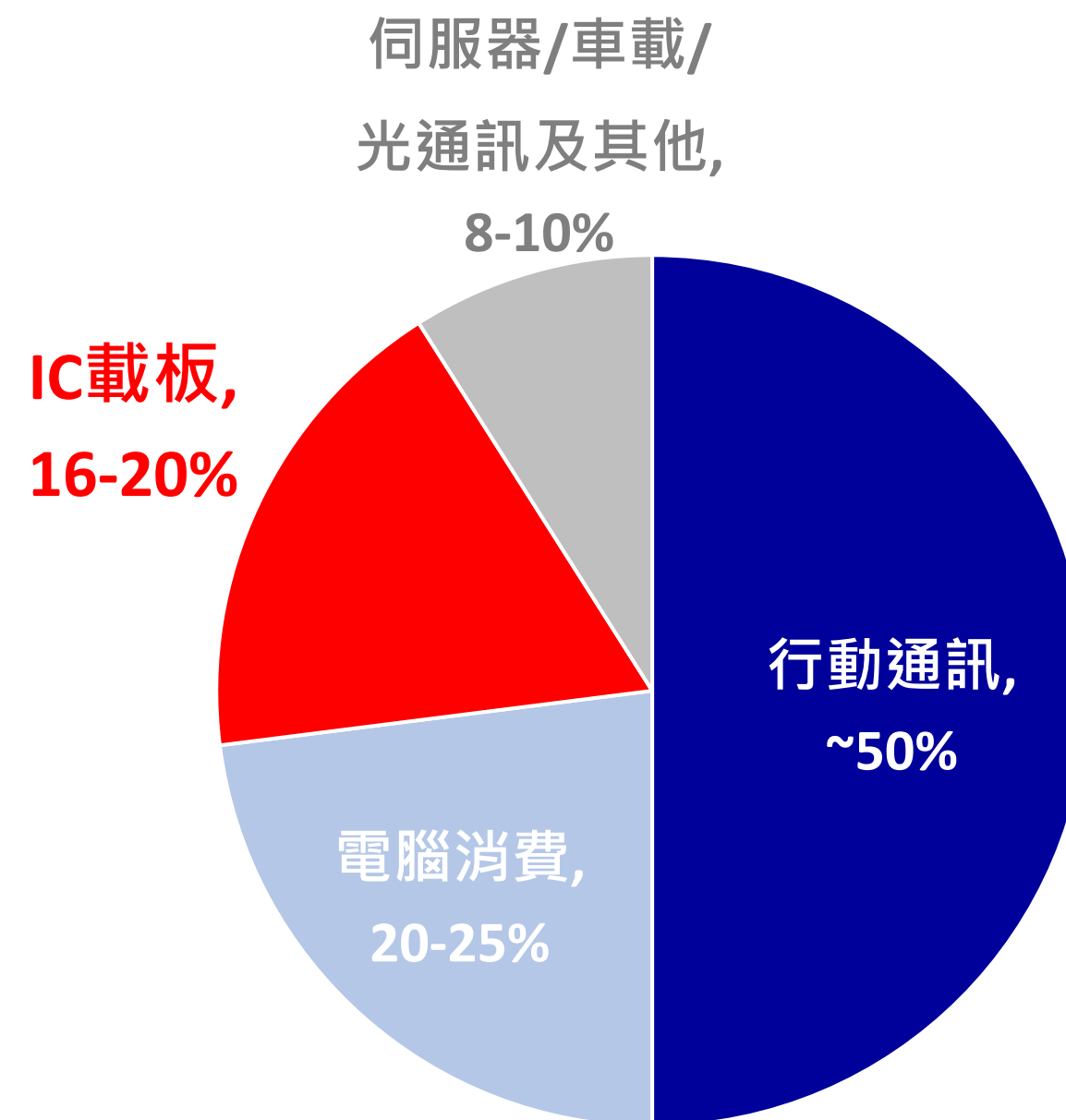
以先進技術領航，  
IC載板業務快速成長

# 穩步推進IC載板佈局，持續擴大營收貢獻

臻鼎：2024年產品應用營收佔比

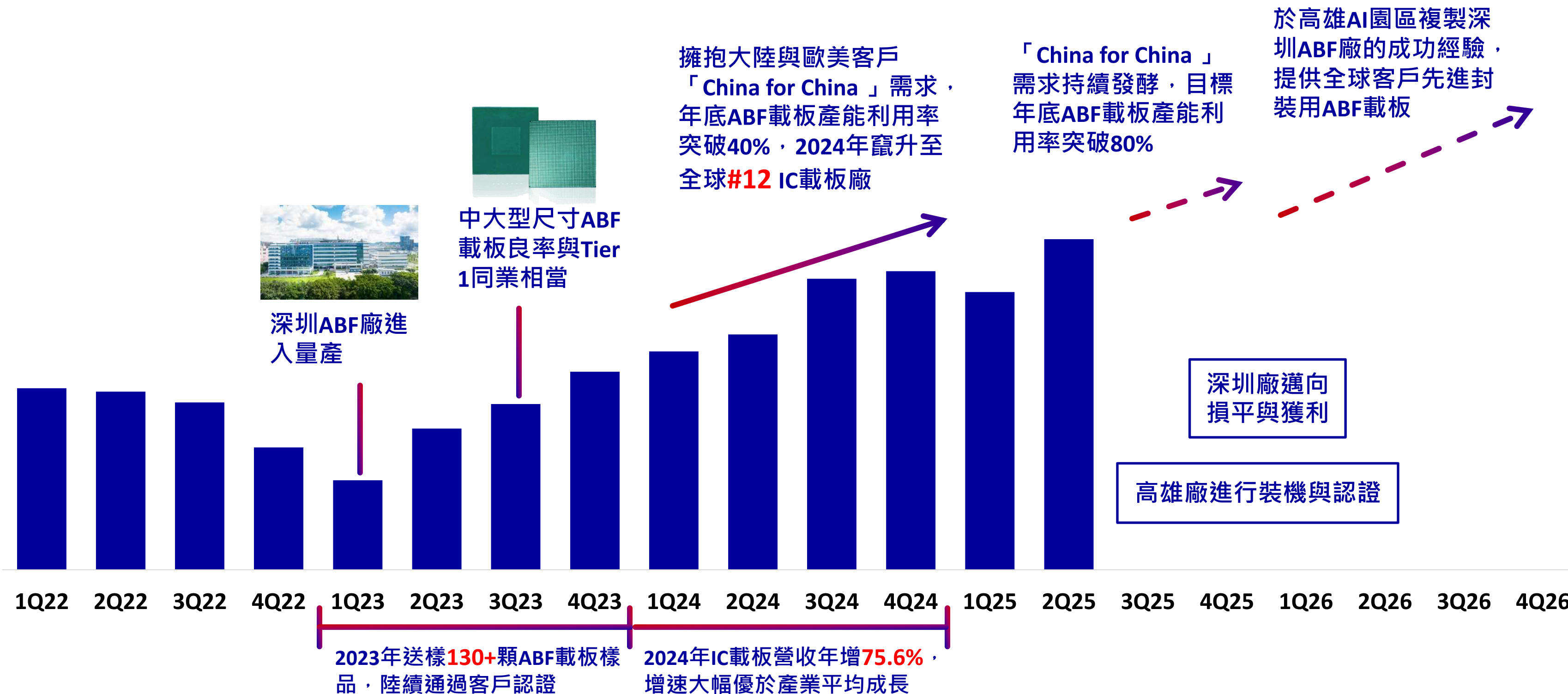


臻鼎：2030年目標產品應用營收佔比



# 擁抱「China for China」需求， 同時以先進封裝用ABF載板擴大Outside China客戶群

## 臻鼎IC載板營收趨勢



# 目標2030年躋身全球前五大IC載板廠

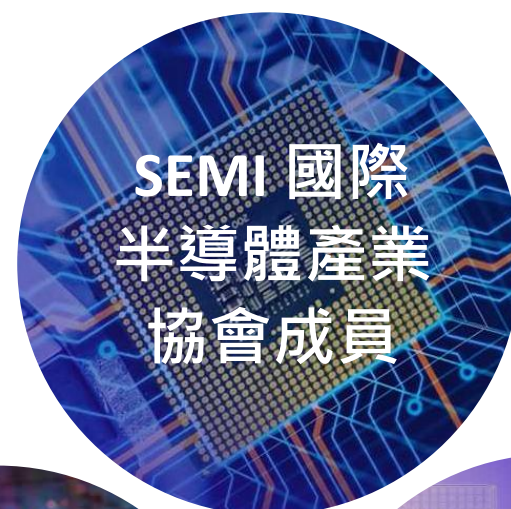
## 專注高階需求

- 以業界最先進的IC載板生產基地，專注客戶高階需求。
- 受惠於AI、高速運算與先進封裝技術的快速發展，高階ABF載板在大尺寸(70mm\*70mm以上)及高層數(16層以上)產品需求持續成長。
- 持續開發新技術平台產品，待客戶認證通過後有望於2H25開始貢獻營收。



## 串聯半導體產業鏈

- 積極參與半導體產業相關組織，與上下游企業密切合作，拓展在新興技術領域的市場機會。



## 複製大陸經驗至高雄AI園區

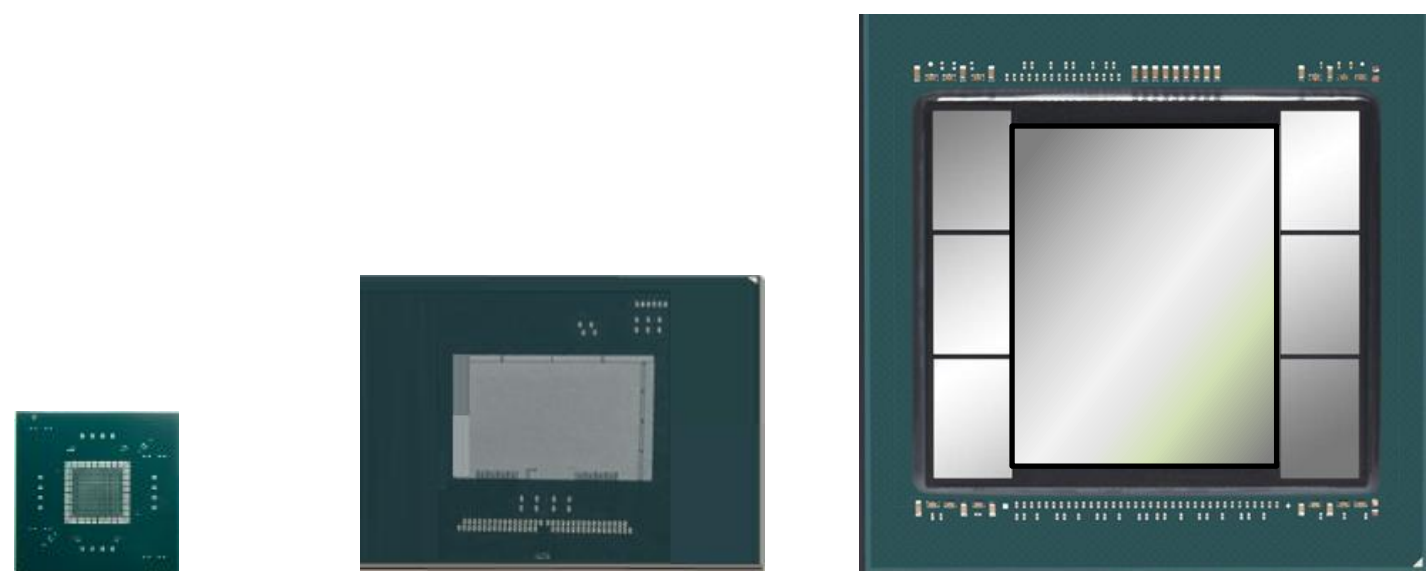
- 大陸廠區以高品質、高良率、高效率深受客戶肯定，產能利用率持續拉升。
- 將複製大陸成功經驗，於高雄AI園區建置全流程之先進封裝用FCBGA量產場域，重點開發分布於亞洲與歐美的指標型半導體客戶。
- 臻鼎為首家進入台灣科學園區的PCB廠，在技術與環保方面符合高標準。



# 臻鼎ABF載板技術能力與Tier 1競爭者相當， 致力爭取全球領先半導體客戶

## ABF載板發展趨勢

層數**高**、尺寸**大**、表面**平**、產品精度**準**



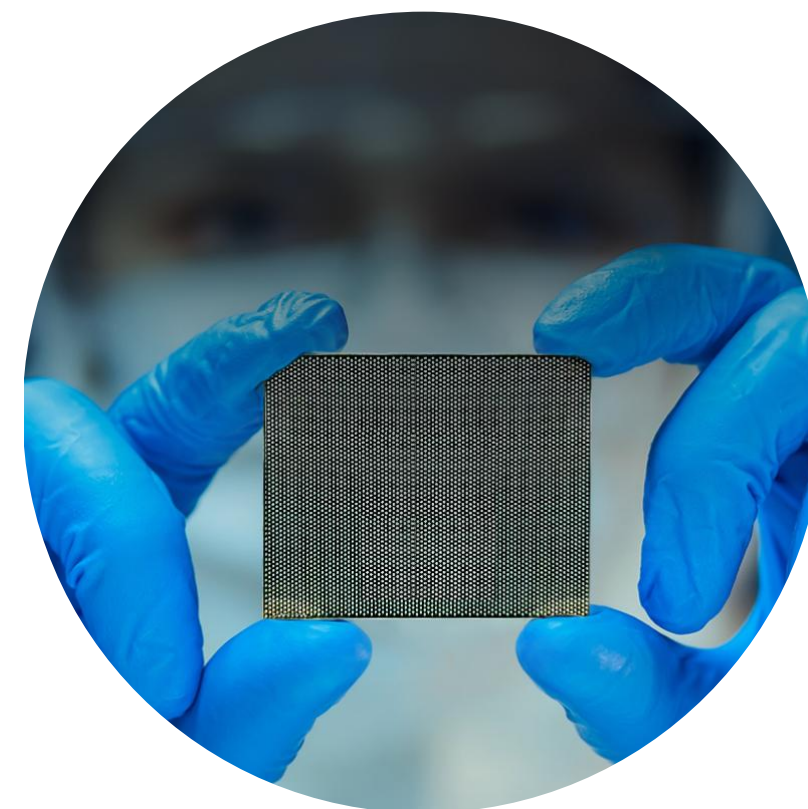
2005

2020

2026

Body Size (mm)	31 x 31	75 x 60	120 x 140+	<b>x20+</b>
Layer count (L)	6	20	28+	<b>x4+</b>
Bump Count	1K	100K	300k+ ~ 500k+	<b>x300+</b>

臻鼎技術能力已達  
產業領先水準



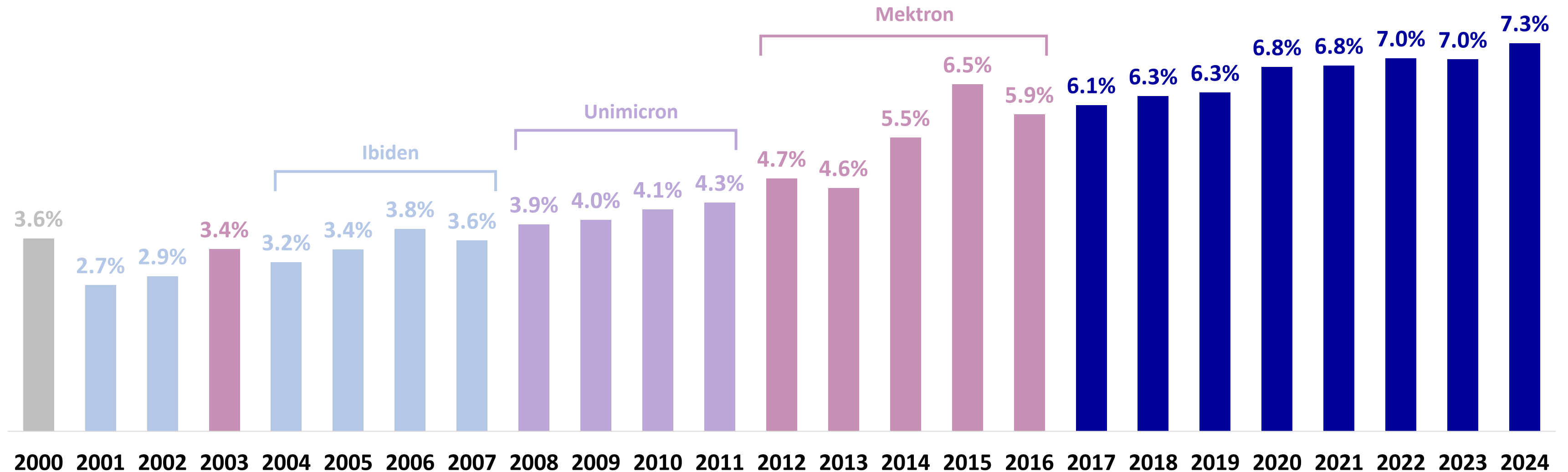
強化領先優勢，  
擴大市場版圖

# 臻鼎持續居於產業領先地位

歷年全球最大PCB廠商市佔率

■ Sanmina ■ Ibiden ■ Mektron ■ UMTC ■ ZDT

**臻鼎連續 8 年市佔率全球第一**  
(且為PCB產業歷年來首家突破7%市佔率的公司)

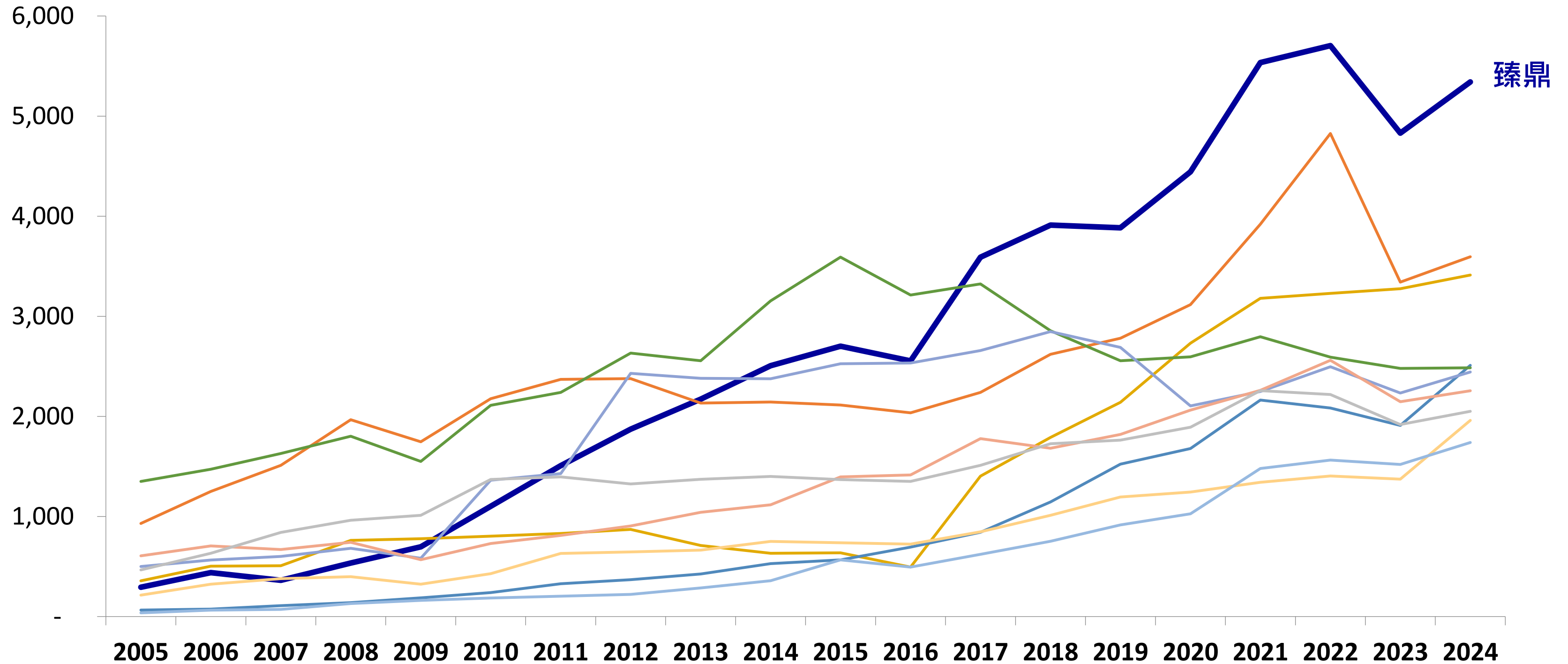


資料來源：Prismark

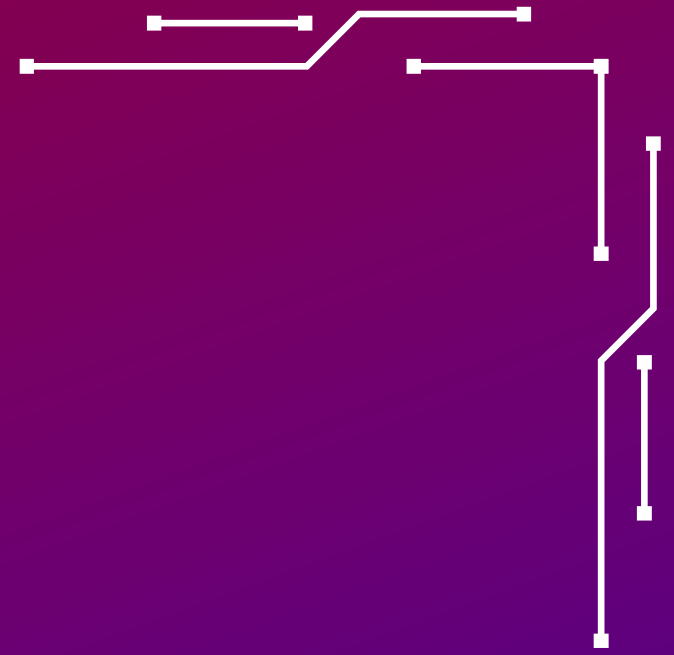
# 臻鼎保持與同業間的領先差距

2024年全球前十大PCB領導廠商營收趨勢

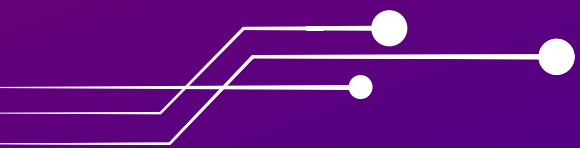
單位：百萬美元



資料來源：NT Information；Prismark (2025/03)

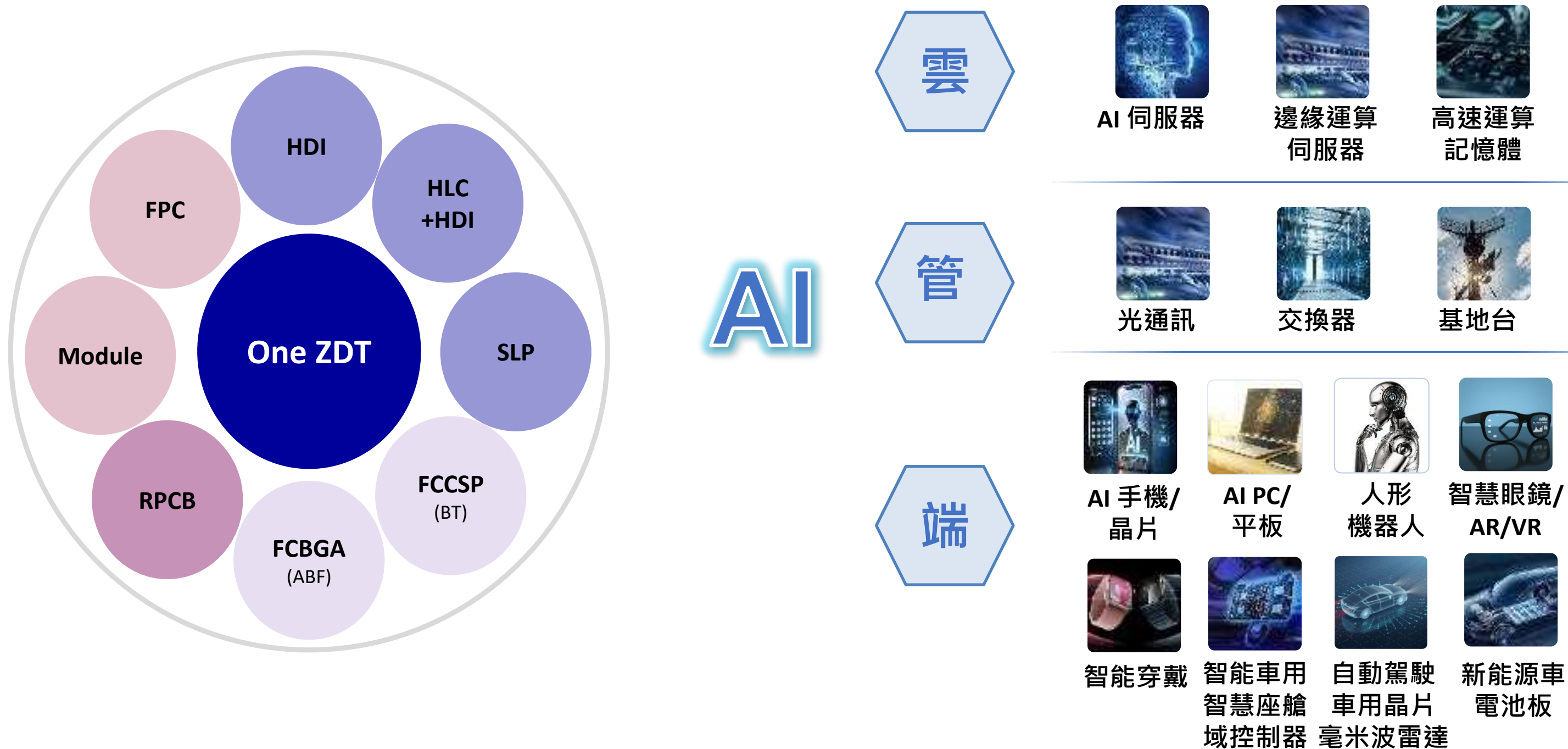


# 為何臻鼎能持續保持領先地位?



# 臻鼎：唯一橫跨全產品線的PCB領導者

憑藉One ZDT的全產品布局，臻鼎全面覆蓋AI時代的雲、管、端應用，提供最完整的解決方案，確保在PCB技術日益複雜的競爭中，穩居全球領導地位。

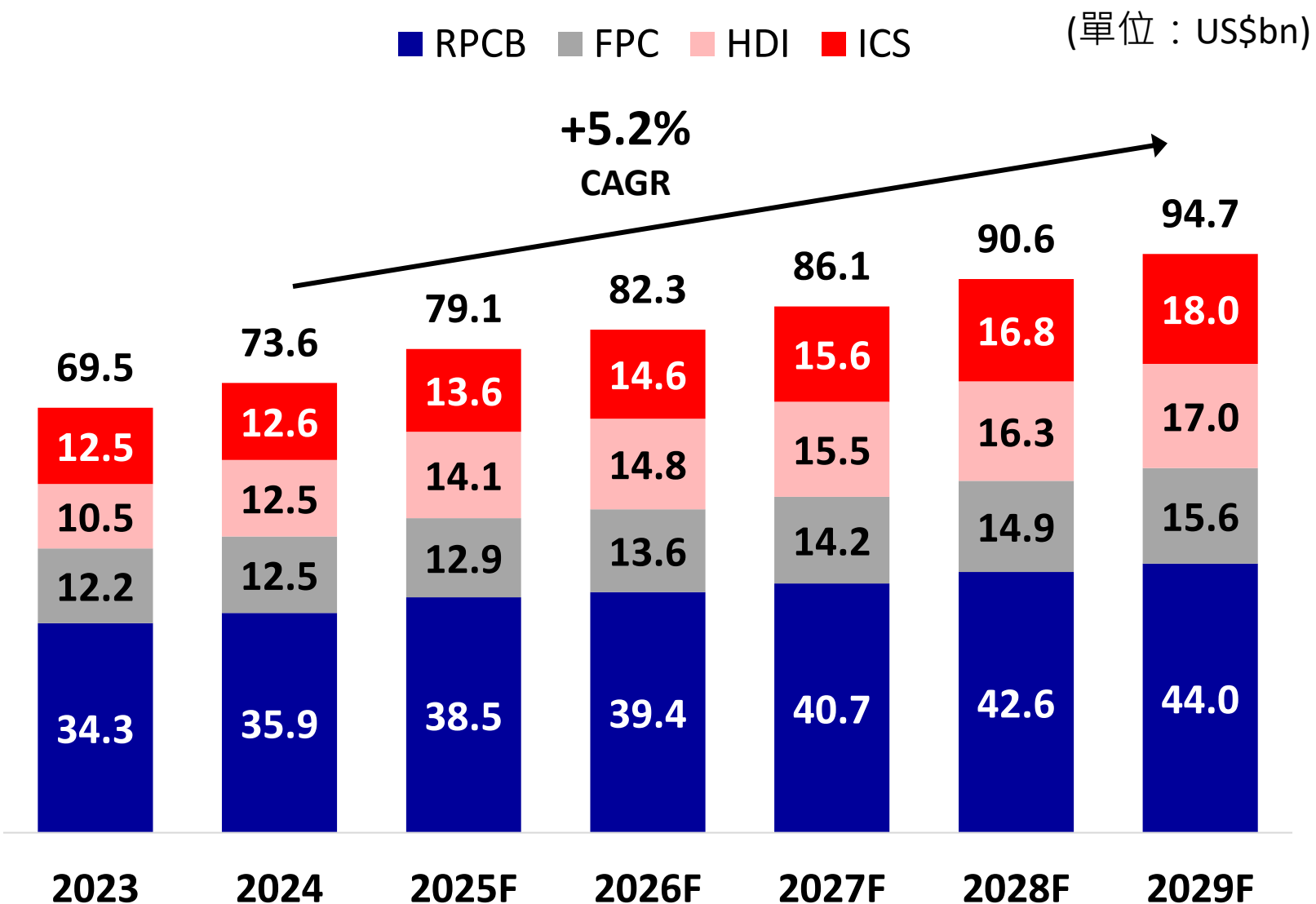


# AI是推動PCB產業成長的重要動能， 臻鼎將以全產品優勢在AI時代拉開與同業的領先差距

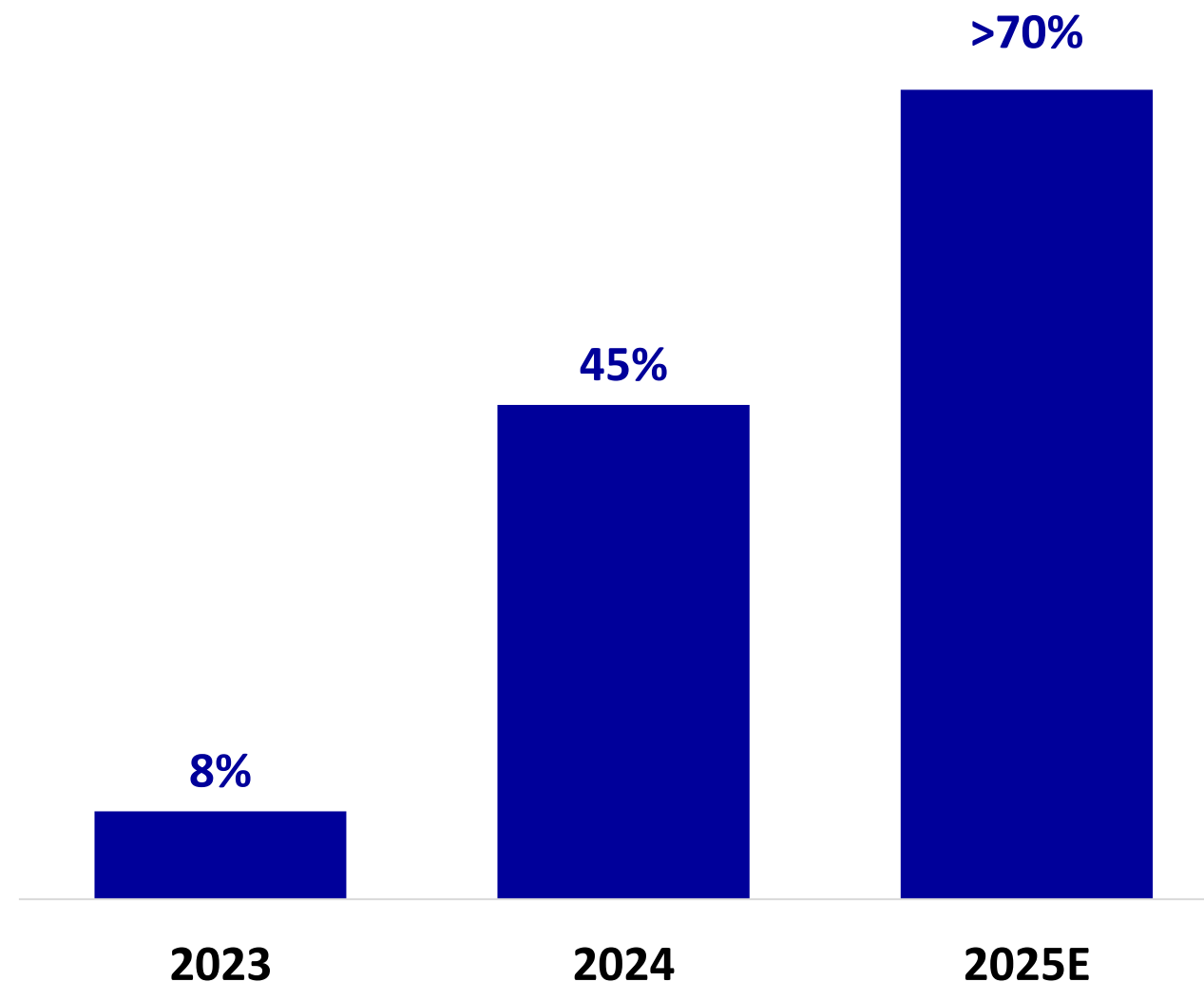
各類 PCB皆受益於 AI 帶來的高階性能要求與產品創新浪潮，AI仍將是PCB產業未來數年的核心成長動能

臻鼎全面覆蓋AI時代的雲、管、端應用，AI營收佔比逐步提高

全球PCB各產品市場規模

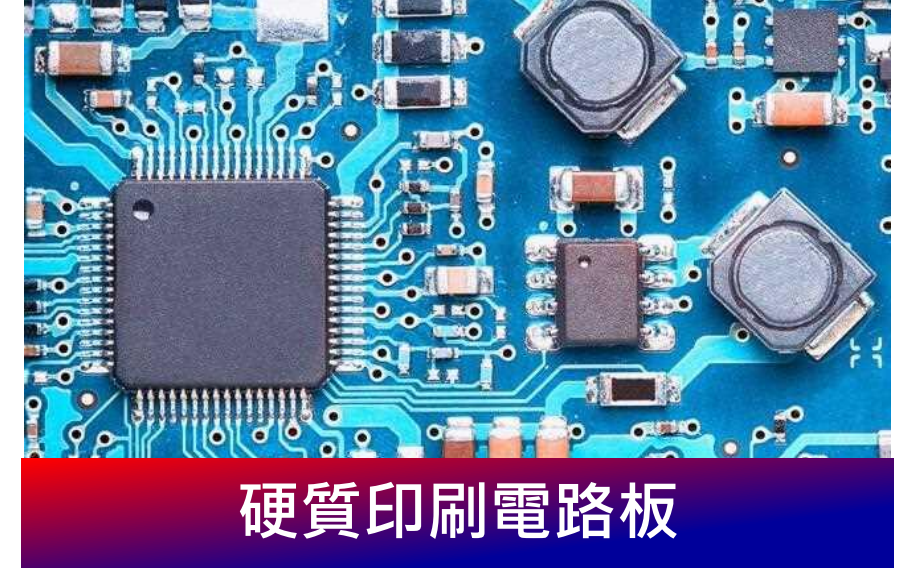
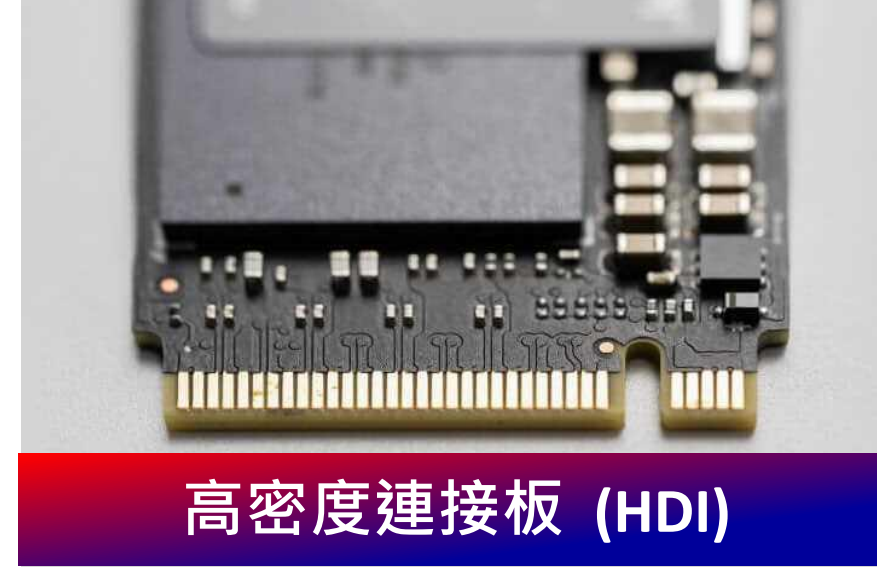
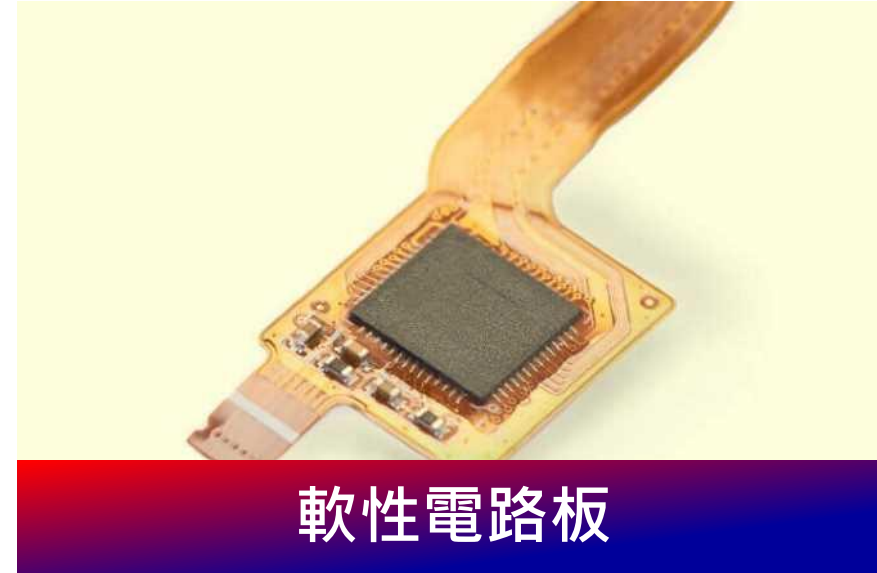


■ 臻鼎AI營收占比



資料來源：Prismark (2025/6)；2026~28年係用Prismark數據推估。

# 過去幾年耕耘逐步發酵，臻鼎四大產品線將持續成長



2030目標

全球前5

2030目標

保持#1

2030目標

全球#1

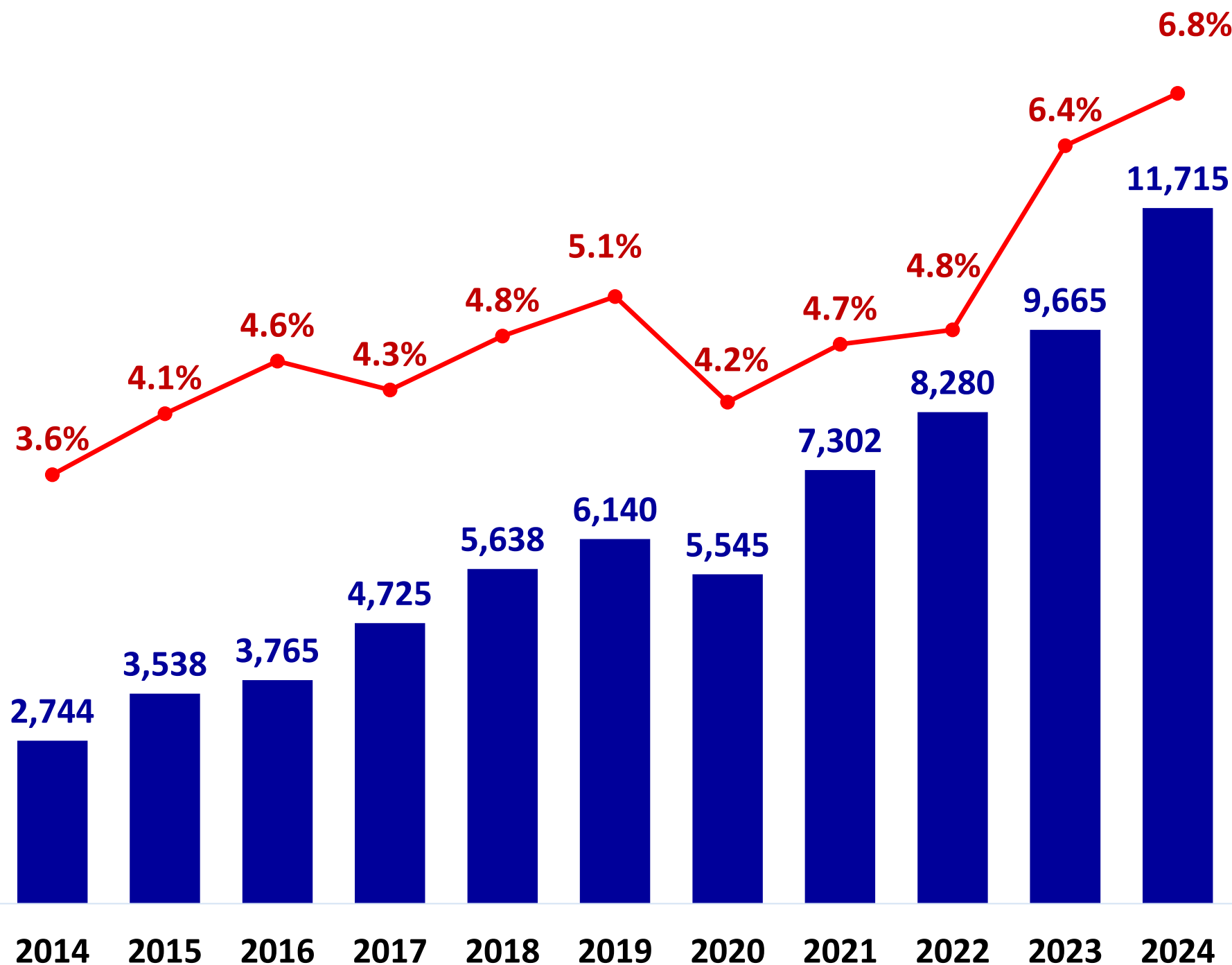
2030目標

全球前10

深化與客戶及產業鏈夥伴合作，目標每年創造優於產業平均的營收與獲利成長

# 持續投入高階產品研發，鞏固產業領導地位

■ 研發費用    ● 研發費用佔營收比例 (%)    單位：新台幣百萬元



在印刷電路板和半導體相關開發計畫上，臻鼎遵循12字方針，研發高階技術並引入到各項具有前瞻性之領域應用中。

## 12字方針：

- |                            |                              |                     |                        |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>輕</b> 輕型化               | <b>薄</b> 薄型化                 | <b>短</b> 流程短        | <b>小</b> 小型化           |
| <b>高</b> 高頻、<br>高速、<br>高散熱 | <b>低</b> 低污染、<br>低成本、<br>低功耗 | <b>多</b> 多功能、<br>多層 | <b>快</b> 快速研發、<br>快速製造 |
| <b>精</b> 公差精進              | <b>美</b> 美觀                  | <b>細</b> 細線路        | <b>智</b> 智能化           |

實施台灣及大陸雙研發中心，持續提升新技術開發能力，以保持高端產品及技術之領先優勢。



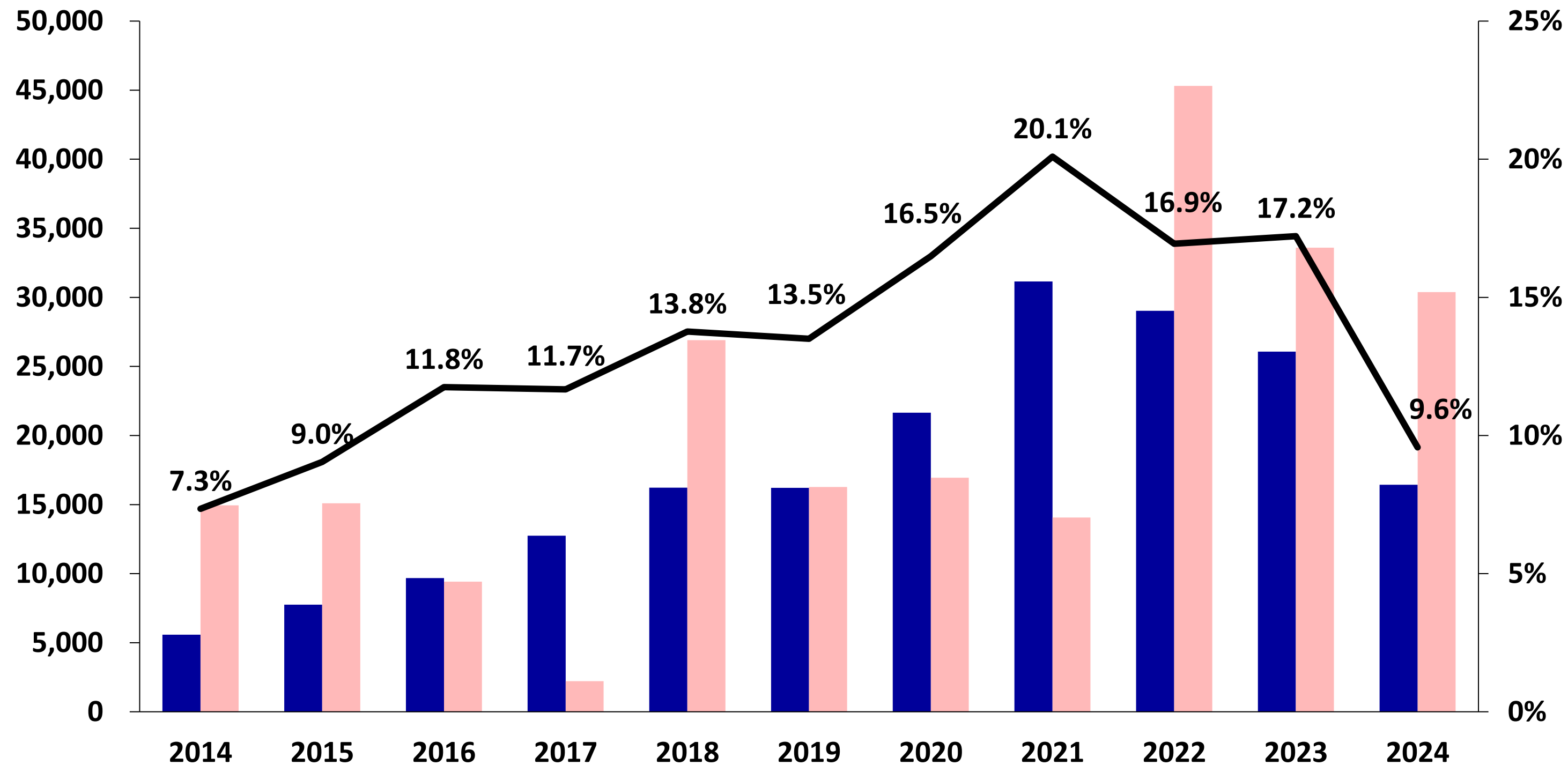
臻鼎科技控股  
Zhen Ding Tech. Holding

擴產有依，穩健前行，  
搶占市場先機

# 以強勁的現金流審慎支應資本支出， 穩健面對總體環境變化

單位：新台幣百萬元

■ 資本支出    ■ 來自營運之現金流量    — 資本支出/營收 (%)



## 擴產規劃



大陸廠區

- 2025年預計在淮安園區擴充AI產品用高階HDI、HLC產能，另外亦將擴充去瓶頸高階軟板產能。



泰國巴真府廠區

- 泰國一廠自5/8試產以來，已有伺服器及光通訊領域重要客戶通過認證，預期4Q25將進入小量產；泰國二廠亦積極建設中。



高雄AI園區

- 預計投入新台幣80億元購置IC載板生產設備，建置全流程之先進封裝用FCBGA量產場域。
- 預計投入新台幣20億元購置HDI+HLC PCB 生產設備。
- 軟板產線已開始貢獻營收。

## 提升營運效益之策略

- 各廠區分階段導入智慧工廠與數位轉型，提升營運效率，確保單位人均產值有效提升，進一步提升整體獲利率。
- 除了已通過認證的客戶之外，尚有多家伺服器與光通訊全球領先客戶正積極進行認證中。泰國一廠以高階RPCB/HDI產品為主，量產後有助於優化產品組合，提升毛利率。
- 規劃生產超高階產品(30L~80L)。
- 高雄AI園區之高階ABF載板與HLC+HDI產能陸續裝機，將於年底進入試產，1Q26進入小量產。

# 多元生產基地建置高階產能，滿足全球客戶需求

## 印度



### 清奈園區

FPC先進模組



## 泰國



### 巴真府園區

2025/5/8試產

## 大陸 深圳



### 深圳第一園區

FPC與先進模組/HDI



### 深圳第二園區

FPC先進模組

## 大陸 秦皇島



### 秦皇島園區

FPC與先進模組/  
SLP高階 HDI

## 大陸 淮安



### 淮安第一園區

RPCB/HDI



### BT載板園區

FC-CSP/WB-CSP/  
Memory，第一期  
2022年量產



### 淮安第二園區

FPC與先進模組/  
HDI/Mini LED 背光  
超薄細線路電路板



### 淮安第三園區

高階 HDI/MSAP，  
2023年量產

## 台灣



### 高雄AI園區

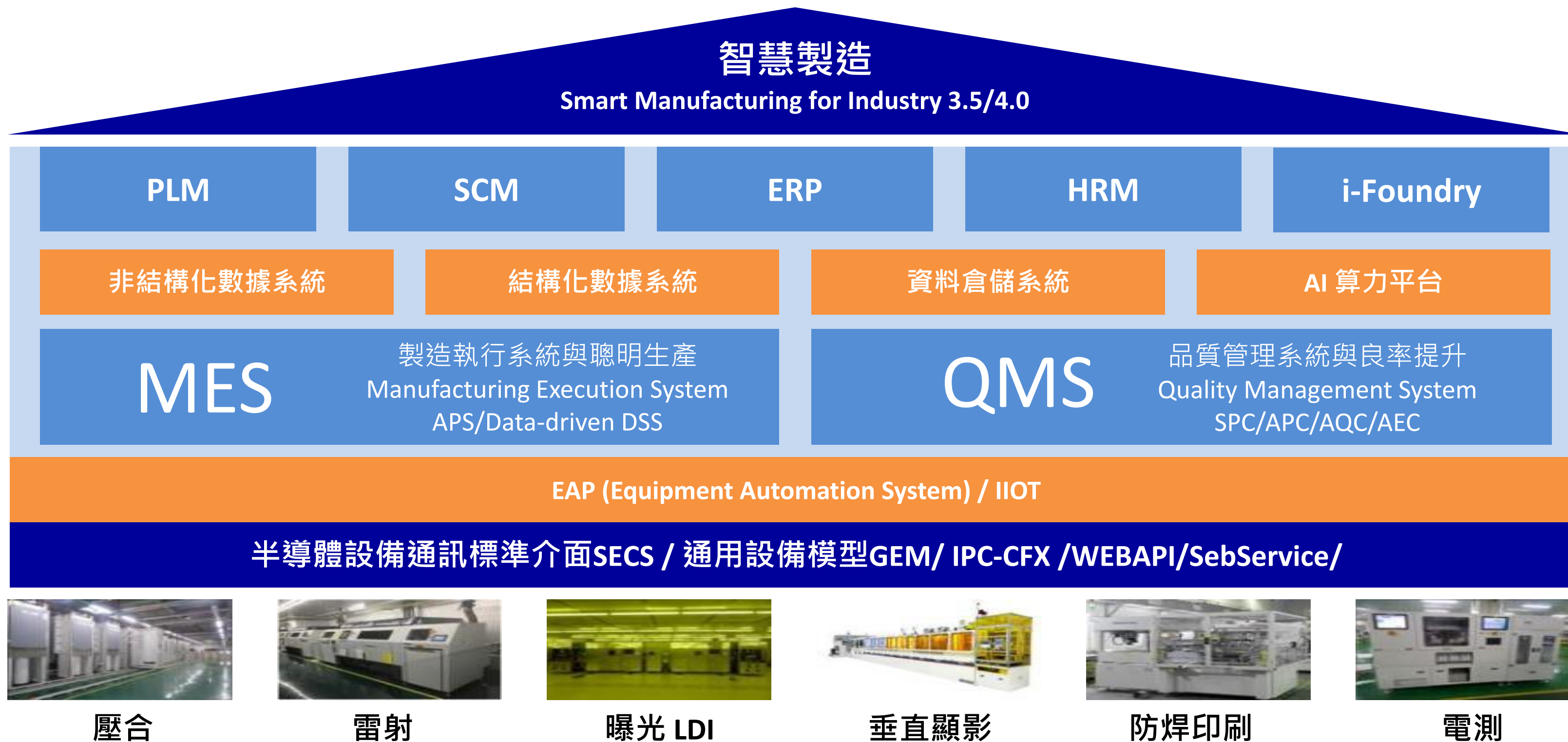
AI產品之研發暨生  
產據點



### ABF載板園區

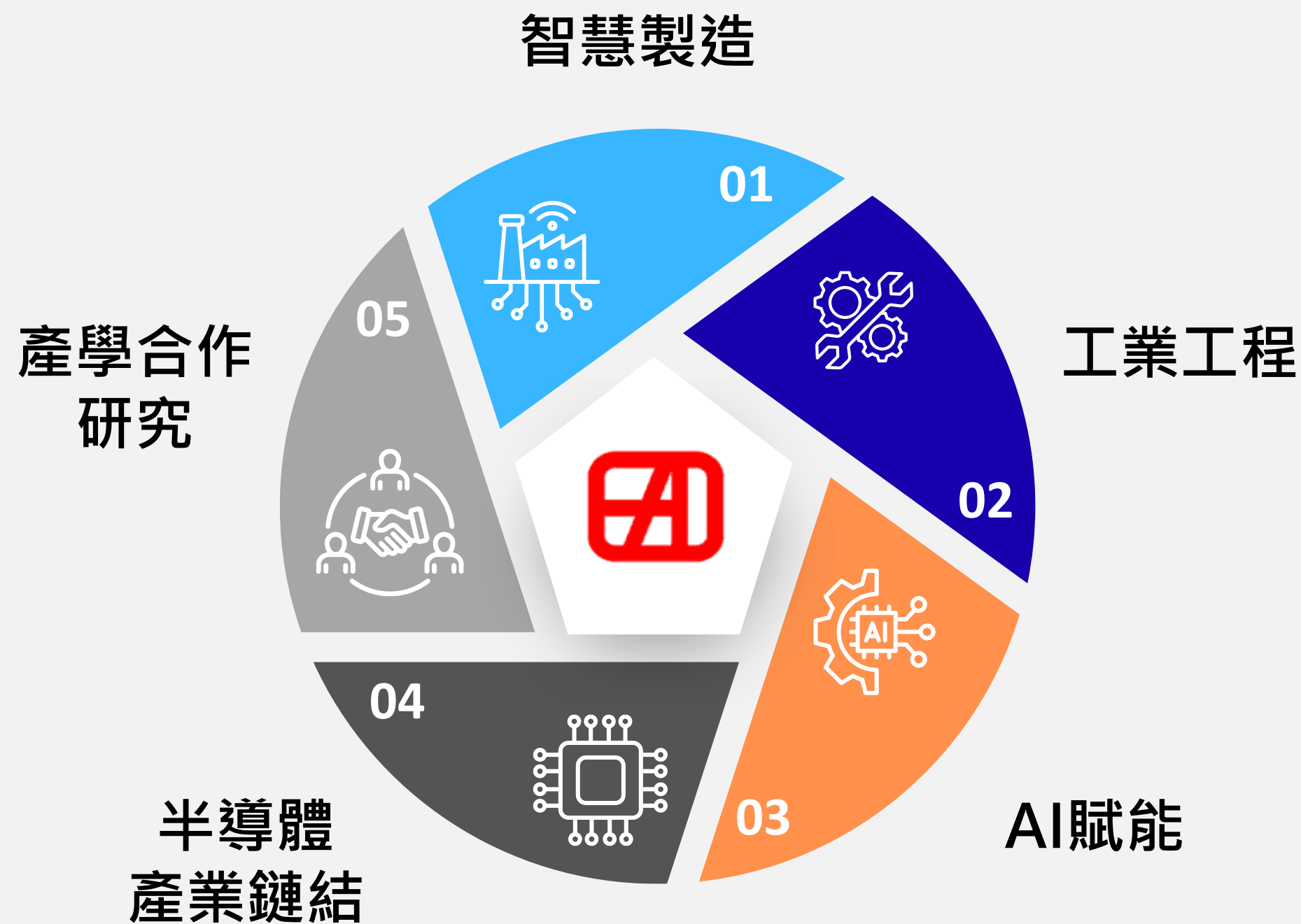
第一期2023年量產

# 透過智慧製造，提高人均產值，創造更佳獲利



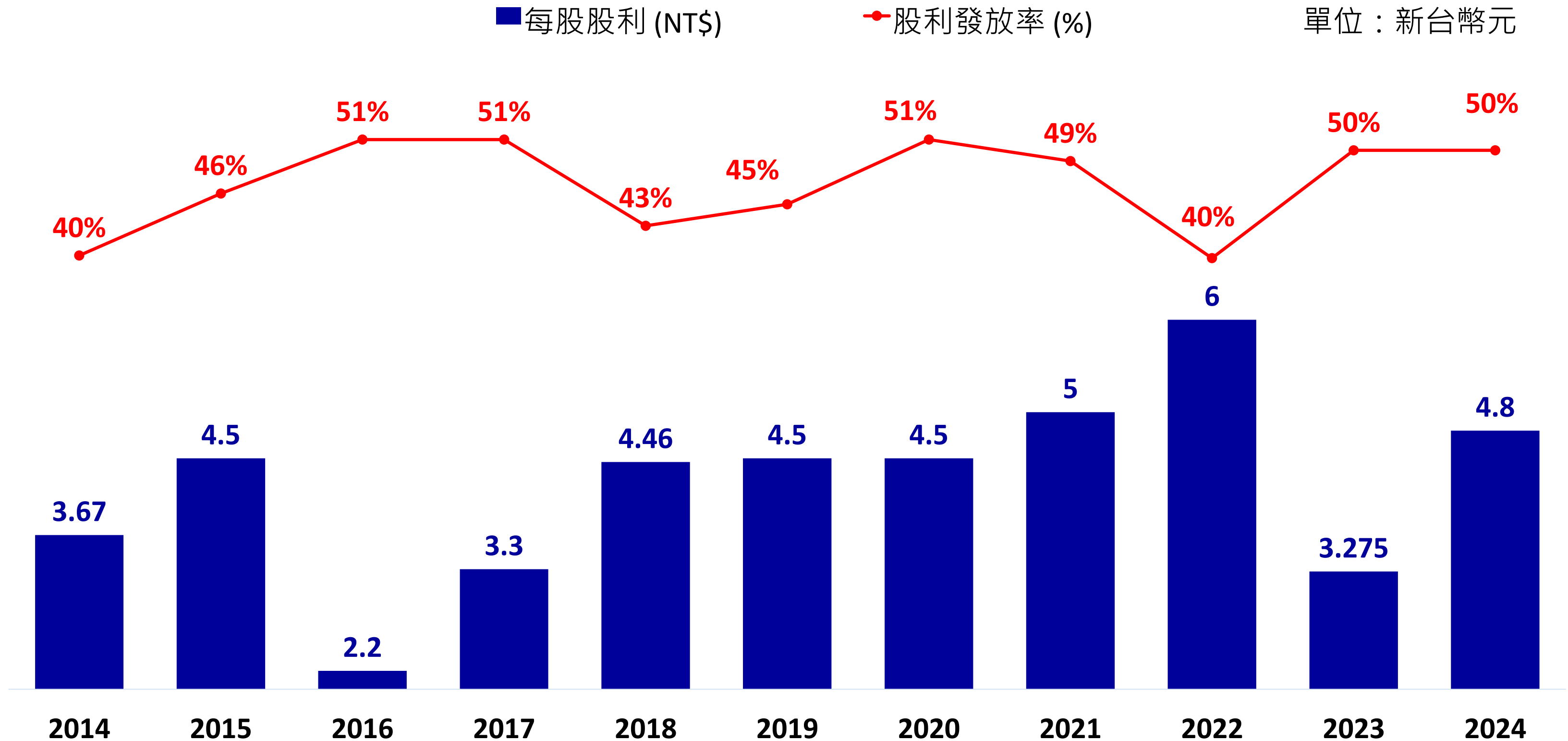
作業數位化、數位平台化、平台智能化、智能實戰化

# 團隊賦能，全面強化臻鼎營運韌性與永續競爭力



提高組織內外資源整合，  
實現團隊賦能與結構性優化

# 維持高股息發放率，與股東共享經營成果



# 致力推動EPS + ESG，國際ESG評比持續提升

## ▶ 臺灣公司治理評鑑

2024年公司治理評鑑排名上市公司6%-20%，再度入選臺灣證券交易所公司治理100指數。

## ▶ 標普全球企業永續評鑑 S&P Global ESG

2024年S&P Global ESG 評級進步至78分，連續3年入選標普全球永續年鑑 (Sustainability Yearbook)，為台灣唯一入選的PCB企業。

## ▶ Sustainalytics ESG 風險評級

最新Sustainalytics ESG風險評級為15.7，為低等風險等級。

## ▶ ISS ESG 評級

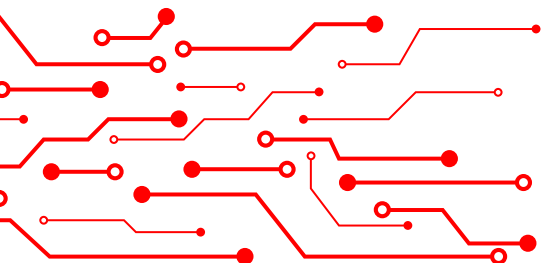
最新年度的ISS ESG評級由「C」進步至「C+」，獲得「優秀 (Prime)」等級。

## ▶ CDP 碳揭露專案

2024年在水安全管理獲得「A」最高等級殊榮，較去年進步一等級。在氣候變遷獲得「B」等級。

## ▶ 富時羅素 FTSE Russell ESG

最新年度的FTSE Russell ESG評級獲得4.4分（滿分為5分），成為台灣上市櫃公司並列第五名。



# 營運成果摘要

# 上半年營運成果

單位: 新台幣佰萬元, 除另予註明者外

	1H25	1H24	年變化 (%)
營業收入	78,285	64,922	+20.6%
營業毛利	12,896	9,584	+34.6%
<b>營業毛利率</b>	<b>16.5%</b>	<b>14.8%</b>	<b>+1.7ppts</b>
營業費用	9,415	9,485	-0.7%
營業利益	3,481	99	3,415.1%
<b>營業利益率</b>	<b>4.4%</b>	<b>0.2%</b>	<b>+4.3ppts</b>
營業外收入及支出	248	1,908	-87.0%
本期淨利	2,413	2,103	+14.7%
<b>淨利率</b>	<b>3.1%</b>	<b>3.2%</b>	<b>-0.1ppts</b>
歸屬於母公司之淨利	1,237	1,463	-15.4%
每股盈餘 (新台幣元) <sup>(1)</sup>	<b>1.30</b>	<b>1.55</b>	
研發費用	5,173	5,493	-5.8%
折舊及攤銷	9,255	8,577	+7.9%
營運活動之現金流入	18,254	10,115	+80.5%
現金及約當現金 <sup>(2)</sup>	74,194	69,461	+6.8%
股東權益報酬率 (%) <sup>(3)</sup>	<b>3.4%</b>	<b>3.1%</b>	<b>+0.3ppts</b>

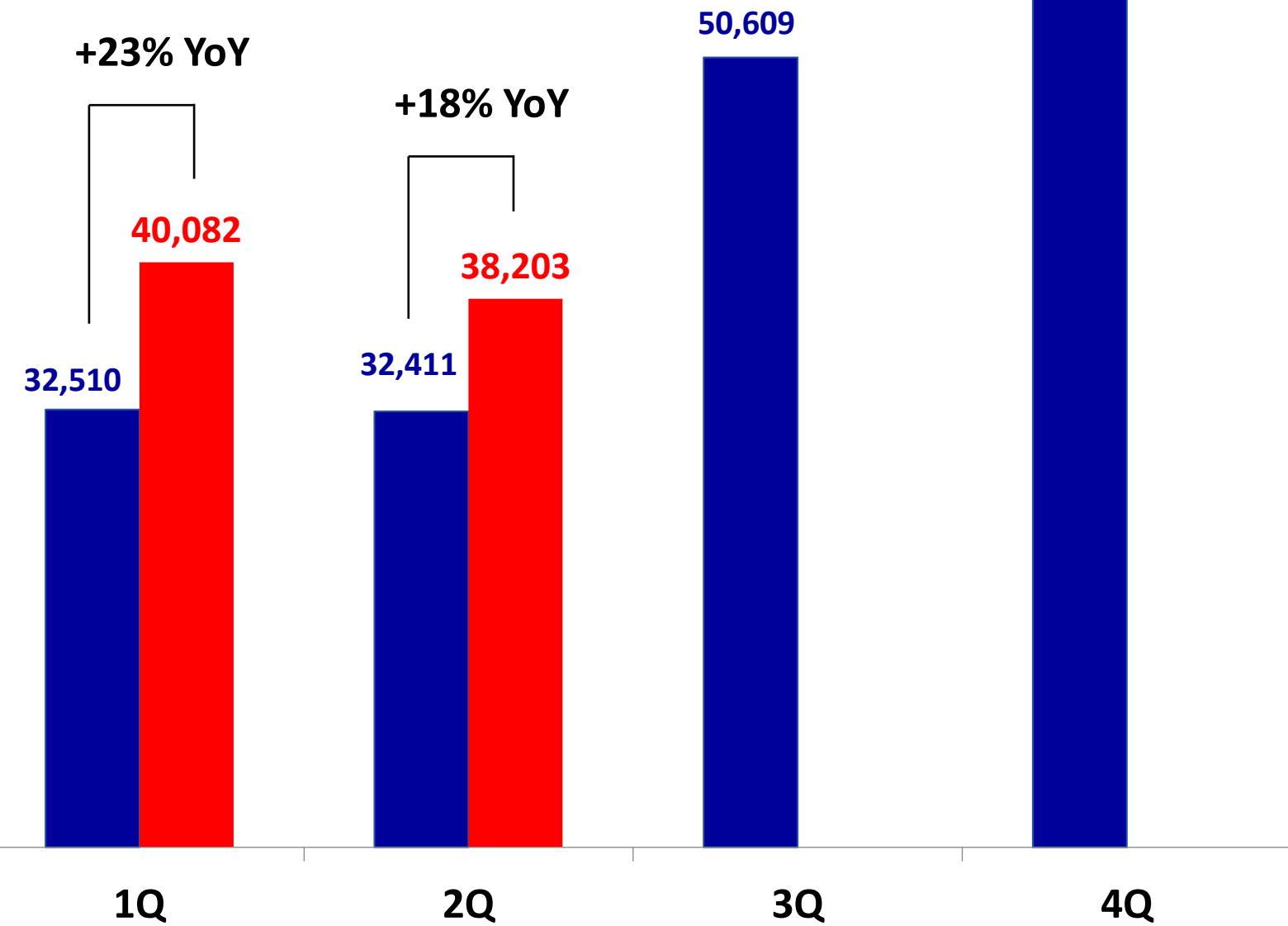
附註：(1) 2025年上半年加權平均流通在外股數為954,559仟股 (實際發行股本956,652仟股-庫藏股2,093仟股)。 (2) 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。 (3) 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據。

# 季度營運成果

## 營業收入

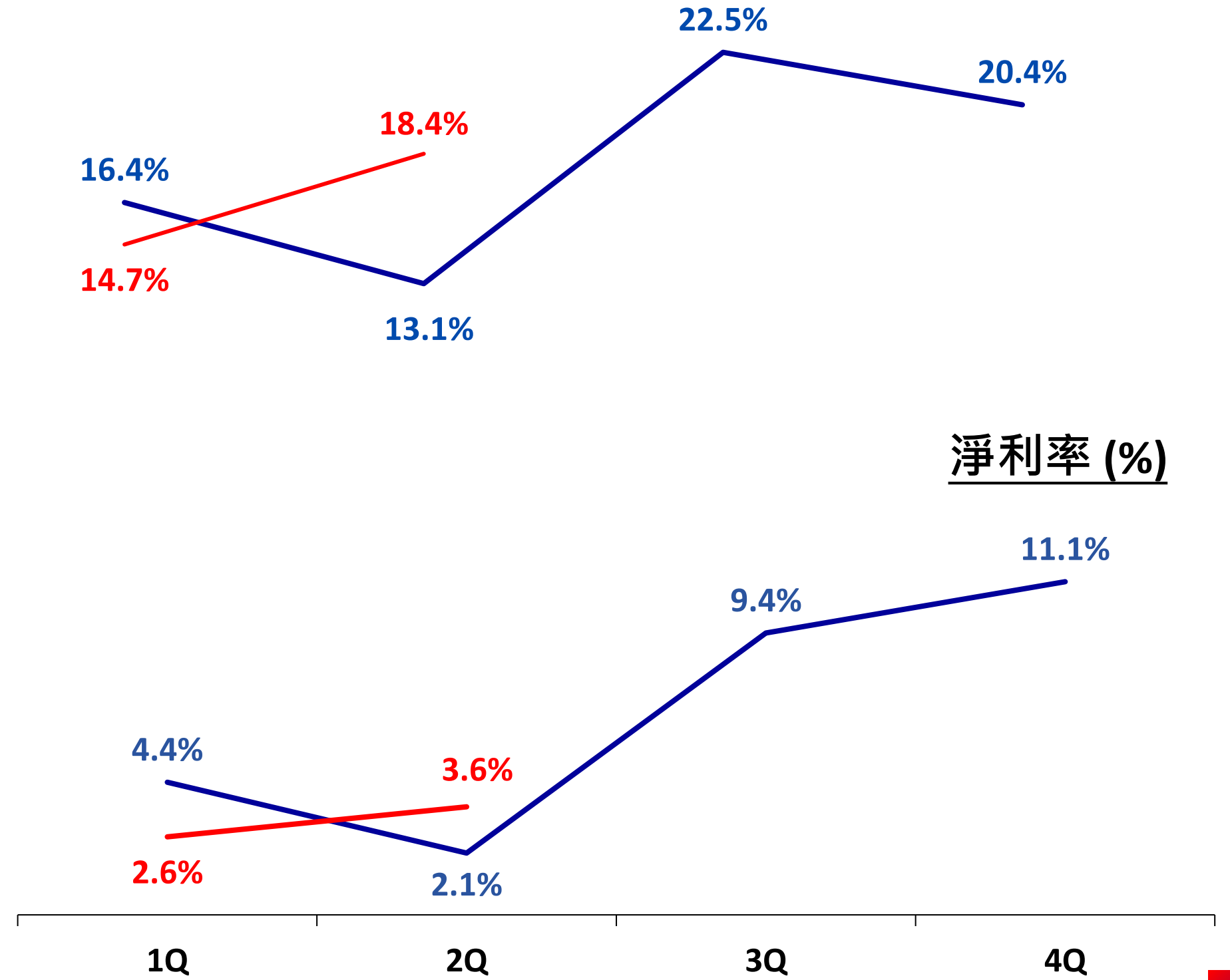
■ 2024 ■ 2025

單位：新台幣佰萬元



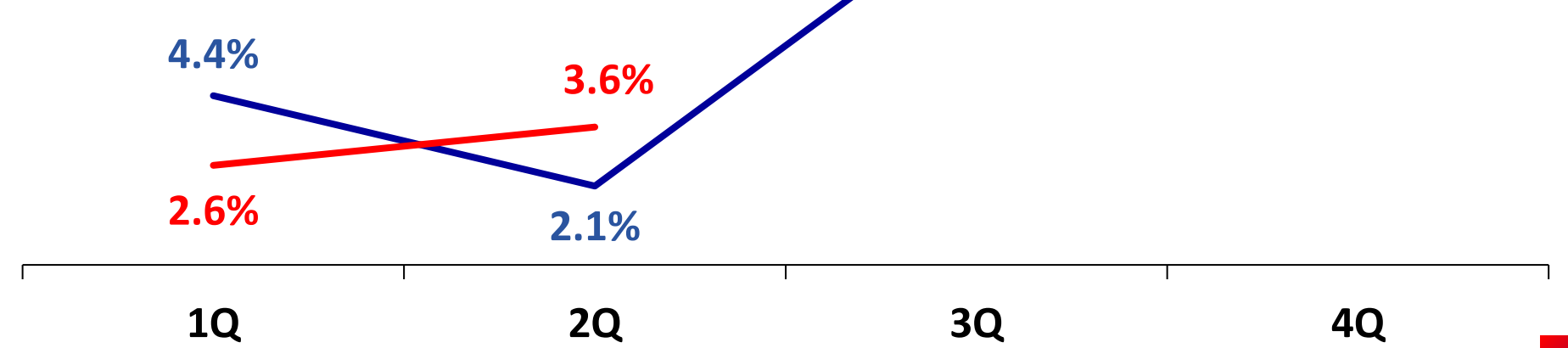
## 毛利率 (%)

— 2024 — 2025



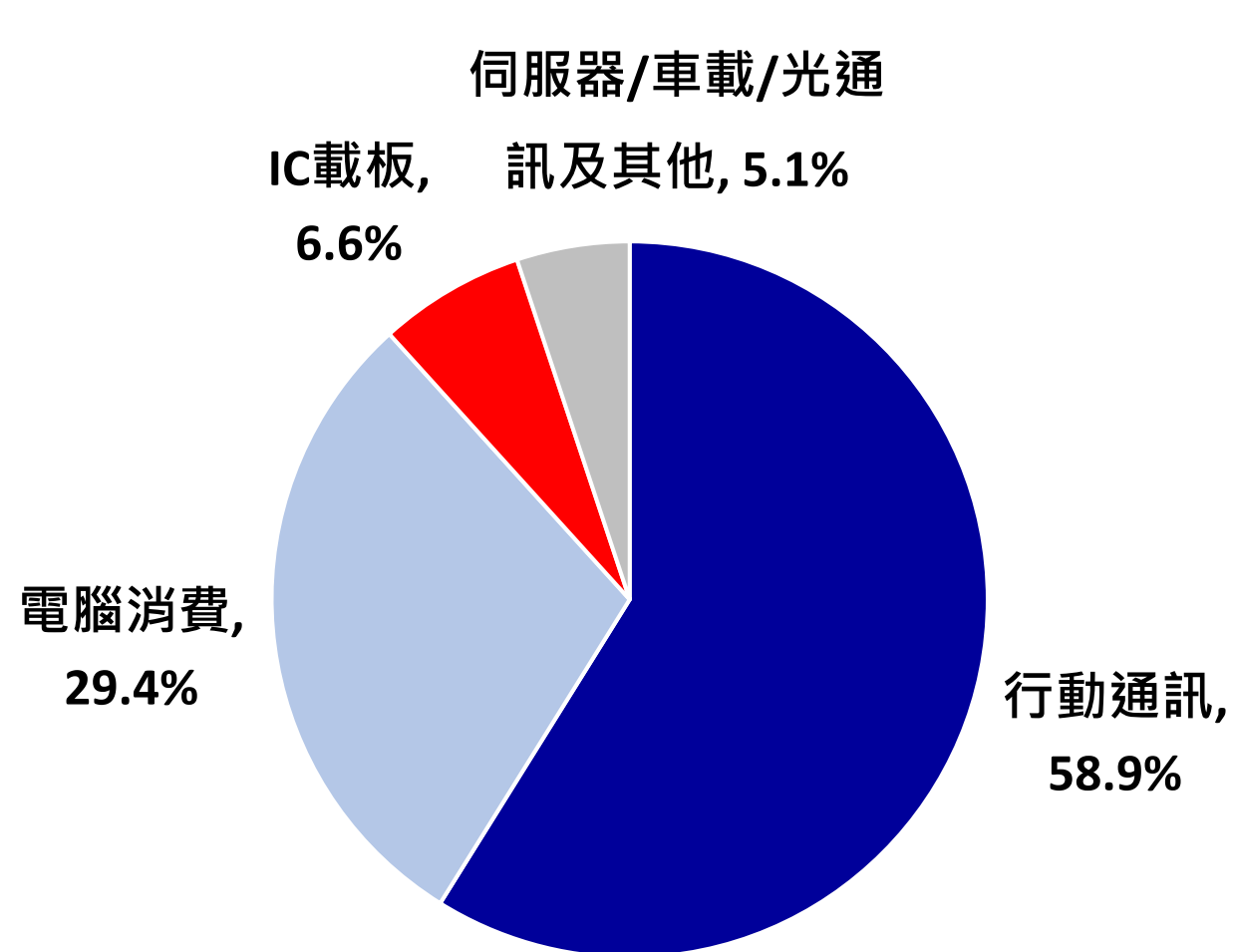
## 淨利率 (%)

— 2024 — 2025

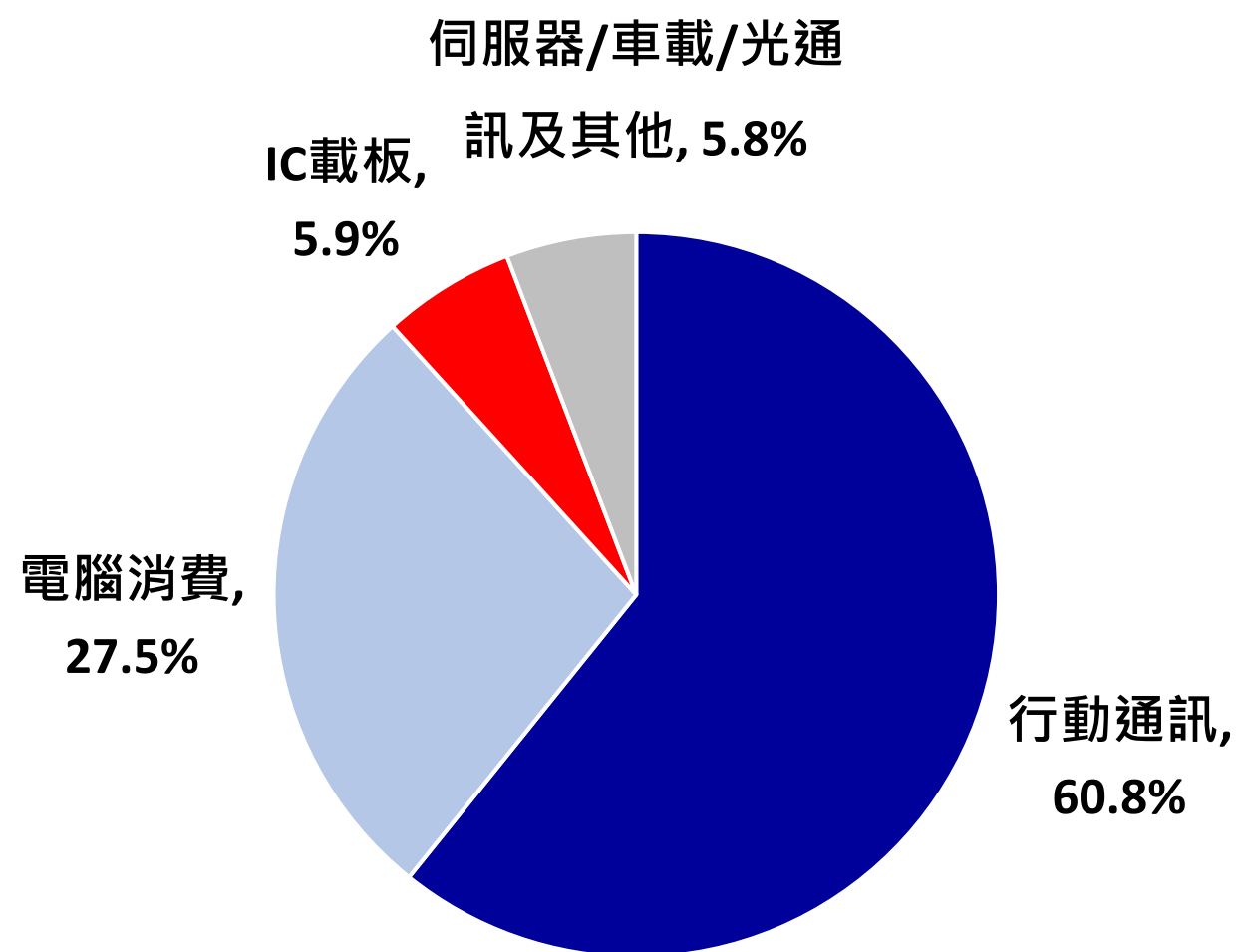


# 銷售分析-產品應用別

1H25營收：新台幣783億



1H24營收：新台幣649億



產品別	1H25營收YoY%
行動通訊	+16.9%
電腦消費	+29.1%
IC載板	+34.7%
伺服器/車載/光通訊及其他	+4.9%

# 資產負債表及重要財務比率

單位：新台幣佰萬元

	2025-6-30		2024-6-30		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金 <sup>(2)</sup>	74,194	30.6%	69,461	28.2%	4,732	+2.5ppts
應收款項	18,409	7.6%	22,317	9.1%	(3,907)	-1.4ppts
存貨	16,178	6.7%	18,784	7.6%	(2,606)	-0.9ppts
不動產、廠房及設備 <sup>(3)</sup>	109,642	45.3%	112,558	45.7%	(2,916)	-0.4ppts
<b>資產總額</b>	<b>242,172</b>	<b>100.0%</b>	<b>246,563</b>	<b>100.0%</b>	<b>(4,392)</b>	
借款	55,438	22.9%	54,590	22.1%	848	0.8ppts
應付款項	41,265	17.0%	37,251	15.1%	4,014	1.9ppts
<b>負債總額</b>	<b>109,026</b>	<b>45.0%</b>	<b>107,321</b>	<b>43.5%</b>	<b>1,705</b>	<b>1.5ppts</b>
<b>股東權益總額</b>	<b>133,145</b>	<b>55.0%</b>	<b>139,242</b>	<b>56.5%</b>	<b>(6,097)</b>	<b>-1.5ppts</b>
<b>重要財務比率</b>						
平均收現日數(天)	57		72		(15)	
平均銷貨日數(天)	51		61		(10)	
流動比率(倍)	1.54		1.76		(0.22)	
資產生產力(倍) <sup>(4)</sup>	1.40		1.17		0.23	

附註：(1) 2025年上半年加權平均流通在外股數為954,559仟股 (實際發行股本956,652仟股-庫藏股2,093仟股)。 (2) 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。(3) 不動產、廠房及設備 包含 投資性不動產。(4) 資產生產力 = 年化營業收入淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額。

# 歷年營運成果

單位：新台幣佰萬元

年度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
營業收入	85,738	82,393	109,238	117,913	120,068	131,279	155,022	171,356	151,398	171,664
營業毛利	16,427	12,542	17,833	26,061	27,222	26,584	30,537	39,888	27,459	32,461
本期淨利	7,731	3,456	6,772	11,536	12,402	11,508	13,694	20,535	9,432	13,096
母公司淨利	7,731	3,456	5,172	8,448	8,685	8,095	9,651	14,197	6,189	9,180
折舊及攤銷	4,850	5,295	5,679	6,820	7,955	8,405	11,875	14,638	16,323	17,749
每股盈餘 (元)	9.80	4.29	6.43	10.50	9.93	8.90	10.21	15.02	6.55	9.67
每股股利 (元)	4.50	2.20	3.30	4.46	4.50	4.50	5.00	6.00	3.275	4.80
分派比率 (%)	46%	51%	51%	43%	45%	51%	49%	40%	50%	50%
現金及約當現金 *	31,572	30,241	33,296	49,154	43,071	46,775	35,179	57,599	65,970	79,830
不動產、廠房及設備	32,074	32,262	36,681	41,913	46,243	68,177	86,073	104,814	109,965	113,462
資本額	8,047	8,047	8,047	8,047	9,022	9,470	9,470	9,470	9,470	9,567
股東權益報酬率 (%)	20.82%	8.59%	14.49%	17.30%	14.72%	11.84%	12.59%	16.67%	7.10%	9.15%
負債比率 (%)	53.70%	59.72%	55.33%	44.25%	35.41%	42.56%	42.01%	42.87%	44.67%	42.85%

\* 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等



**Thank You**